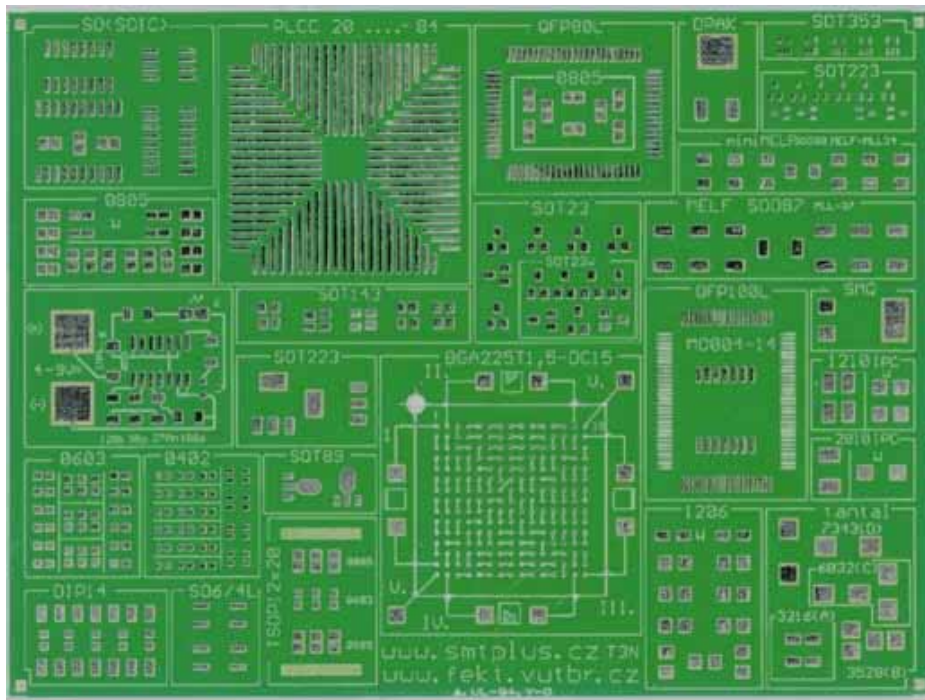


Zkušební deska plošného spoje

Zkušební deska má rozměry 130x98mm, je zhotovena z materiálu FR4 (UMATEXT) tloušťky 1.5mm, Jsou na ní umístěny footprinty pro základní typy pouzder SMD, včetně integrovaných obvodů Flat-Pack a pouzdra BGA. Na desce je umístěno zapojení programovatelné děličky ve funkci jednoduchého blikáče. K desce je možno přibjednat kovovou šablonu pro nanášení pájecí pasty, což umožňuje trénink osazení do pájecí pasty pájení přetavením, tj, ukázkou standartního technologického procesu používaného ve výrobě.



Na desce jsou umístěny footprinty pro pouzdra SMD:

- PLCC 20-84, QFP80, QFP100, BGA 225, MO004-14, TSOP 12x20, SO4-8, SOL4-20, DIP14, SO6/4, DPAK, SOT23, SOT353, SOT223, SO143, SOT89, 3216(A), 3528(B), 6032(C), 7343(D), miniMELF, MELF, SOD80, SOD87, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010, SMQ
- na desce je umístěn motiv pro kontrolu pájecího profilu pro pouzdro BGA225T1,5 s pomocí speciálního testovacího pouzdra. Je s ním možno diagnostikovat chybné připájení jednotlivých oblastí v poli kuličkových BGA kontaktů. Motiv lze použít pro testovací pouzdra označená jako DC 15.

Desku doporučujeme společně se zařízením SBTISK pro výuku a ukázkou procesu nanášení pájecí pasty.

Cena: 120,- Kč (bez DPH)